

〈2〉地政学戦略において高まる グローバルサウスの重要性

三菱 UFJ リサーチ & コンサルティング株式会社
グローバルコンサルティング部
マネージャー 清水 昂星

米中対立の深まりとグローバルサウス 諸国の台頭

2025年1月、第二次トランプ政権の発足により、世界を取り巻く地政学リスクの火種はくすぶり始めている。トランプ大統領は就任後間もなく、諸外国に対する関税強化を引き合いに、ディールを通じた“果実”を得る戦略を繰り返している。その中で、特にやり玉に挙げられている国の1つが、中国である。3月には中国に対する追加関税率を10%から20%に引き上げる大統領令を発令し、4月には相互関税として34%を課すと公表。中国もそれに対抗する形で米国からの肉類や穀物へ追加関税を課すなど、制裁の応酬がやまない。こうした米中対立の深まりは、第一次トランプ政権下の2010年代後半から度々議論になっており、経済は振り回されている状況である。グローバルにサプライチェーンを構築している企業は多大な影響を受けており、いわゆる敵対国の製品・技術の導入禁止や関税を回避するため、サプライチェーンの再編を迫られている。再編に際して主な論点に挙げられるのが、原材料の「調達」、および「製造」拠点のシフトであろう。従来の安価な人件費を背景とした拠点戦略は鳴りを潜めており、経済安全保障を念頭に置いた安定したサプライチェーンの構築が、企業の使命課題となっている。

米中対立によるサプライチェーン再編の動きが強

まる中、調達や製造拠点の候補地として存在感を増しているのが、グローバルサウス諸国だ。「グローバルサウス」に明確な国の定義はないものの、①冷戦後の第三世界に代わる呼称、②相対的に貧しい国々を指す呼称、③立場の弱い南の国々の政治的連帯を指す呼称、等の整理の仕方があると言われている。代表的な国として、インドやアフリカ、南米、ASEAN諸国が対象とされるケースが多い。これらの地域は、将来的な人口増加と経済成長の観点から高いポテンシャルを秘めた市場として語られると同時に、調達や製造のサプライチェーンの適地としても期待されている。従来は、豊富な資源と安価な人件費を背景に、中国がグローバルサプライチェーンの中で調達や製造拠点として重要な役割を担ってきた。しかし、都市部を中心に中国国内の人件費は急騰を続けており、コスト削減を目的とした製造拠点設立の機運は弱まりつつある。また、半導体製造に関わる先端技術の対中供給を制限する政策も、大きな要因の1つである。一方で調達の観点では、米中間の制裁応酬の重要なカードとして、中国はレアアース等重要鉱物の輸出を制限することが常とう手段化している。

これらを背景に、サプライチェーン上のいわゆる“脱中国”の動きが加速しており、次なる適地として、グローバルサウス諸国の名前が挙げられることが増えている。例えば、ASEAN諸国は歴史的に半導体産業の誘致が進んでおり、パッケージングや検

査などを行う後工程に加え、近年では半導体ウェハ製造を含む前工程の生産能力構築を試みている。一方で ASEAN 以外にも製造機能の担い手として地位を狙う地域がある。グローバルサウスの盟主、インドだ。インドは中国の人口を追い抜き世界トップに立つなど、経済成長の著しい国である。また、2023 年の G20 の議長国を務め、「グローバルサウスの声サミット」を開催するなど、リーダー的な立ち位置を強調している。そんな中、インドは国家を挙げて半導体産業の誘致を標榜しており、ASEAN と同様、サプライチェーンの製造機能の一角を担いたいという狙いが透けて見える。また、レアアースなどの調達先として注目を集めている地域がアフリカだ。現在、レアアースの採掘から始まる一連の加工工程の大半を中国が握っており、調達の多角化を進めるため、南部アフリカの持つ採掘・加工のハブ拠点としての可能性が注目されている。自動車の電動化や半導体需要の高まりを踏まえると、レアアースの調達先確保は経済、そして安全保障の両面から喫緊の課題である。こうしたサプライチェーンの脱中国化が進む現代において、各国の戦略資源として重要な半導体の製造や、レアアースを中心とした原料の調達の視点から、グローバルサウスが担う役割をひもといていきたい。

半導体の製造ハブ拠点として存在感を増す ASEAN

ASEAN の中でも、半導体産業の誘致でリードするのがシンガポールとマレーシアだ。シンガポールは今から 50 年以上前に最初の半導体工場が設立されてから、今もなお世界の大手半導体メーカーが拠点を置く産業の集積地である。特にメモリ半導体や、車載向け半導体などを中心に多くの製造工場を持つだけにとどまらず、設計や回路形成などの前工程からパッケージングや検査などの後工程まで、サプライチェーンが確立されている。例えば、米国半導体ファブレスの Broadcom や、ドイツパワー半導体の Infineon、台湾ファブレスの MediaTek など、世界有数の企業がシンガポールに拠点を置いている。シンガポールは、政治的安定性やインフラ成熟度の高さ、そして多くの国々と自由貿易協定を締結しているなど、誘致に適した土壤が整っていることが要因だ。

2025 年には重要産業の変革ロードマップを描いた「ITM2025 計画」をアップデートし、半導体産業におけるシンガポールのリーダーシップ強化を図っている。また、他国との連携強化にも力を入れており、2024 年には米国と AI・半導体産業のイノベーションやサプライチェーン確立において共同声明を発表するなど、着実にステージアップを進めている。その進展を裏付ける大きなポイントとして、前工程工場の設立は見逃せないだろう。米国半導体メーカーの Micron は、シンガポールにメモリ半導体の前工程を置いており、2026 年には AI などで採用が見込まれる広帯域幅メモリ工場の操業を発表した。また、台湾半導体メーカーの UMC は、半導体の製造を一気通貫で手掛けるファウンドリ工場を 2000 年の段階で設立するなど、シンガポールは ASEAN の中でも数歩リードした動きを見せている。

マレーシアも、シンガポールに次ぐ古くからの半導体産業の集積地である。1972 年にインテルが同国のペナン州に進出するなど、米国半導体メーカーを中心にパッケージングや検査工程をアウトソーシングし始めた歴史がある。元々、ペナン州は「東洋のシリコンバレー」とも称される地域であり、企業誘致が積極的に行われてきた。マレーシアは半導体の後工程において世界シェアの 13% を占めているが、近年はより高付加価値な前工程への産業拡大を目標に掲げており、政府も積極的な政策を打ち出している。2024 年 5 月には「国家半導体戦略 (NSS)」を発表し、半導体の設計や前工程を担う工場の誘致、研究開発拠点の設置、高度人材の育成の面で強化を図っている。先行してマレーシアに進出済みの米国半導体メーカーの Intel は、2021 年に以降 10 年間で 8,000 億円以上の投資をパッケージング工場に充当すると報じた。また、半導体素材・部品メーカーも追従する形で投資を進めており、オーストリアプリント基板メーカーの AT&S は新工場の設立を発表している。当面はパッケージングなどの後工程工場の新設や増強が中心となると見られるが、前工程を含めた高付加価値化を狙う動きは継続する模様だ。国家間の連携も進んでおり、2025 年 1 月にはアンワル首相と石破首相が会談を行い、半導体やレアアースなどのサプライチェーン強靱化、および経済安全保障分野での連携強化の意思を交わしている。

一方で、日本や米国と対峙する中国も、マレーシアへの投資を進めている点は興味深い。中国通信機器メーカーの華為の傘下であった xFusion Digital Technologies がマレーシアで GPU サーバを組み立てる工程を置くことで、米国の制裁を回避している。このように、米中対立の流れを受けて、西側諸国と中国それぞれが半導体サプライチェーンの重要な製造ハブ拠点として、マレーシアに注目をしていると言える。

近年、ASEAN 諸国の中で徐々に頭角を現している国がベトナムだ。従来北部を中心に電子部品産業が集積しており、韓国電機・電子部品メーカーの Samsung や、Apple 向けスマホの部品工場の投資など、盛り上がりを見せている。背景にあるのは、中国に対する米国制裁を受けたサプライチェーンの移転だ。高関税や輸入規制を回避するために、中国からベトナムへ工場を移転する企業が散見される。ベトナムは中国と比較して人件費が安いだけでなく、中国と隣接していることから、元々中国で構築されていたサプライチェーンをそのまま活用し、部品をベトナムへ輸入しやすいといった環境が追い風となっている。政府の半導体産業に対する本気度は高く、2024 年 9 月には「2030 年までのベトナム半導体産業の発展戦略と 2050 年のビジョン」を発表。半導体工場の誘致に加え、設計会社の育成、高度技術者の育成など、エコシステム全体の強化を図ったロードマップを策定している。実際に半導体関連メーカーの投資も動き始めており、Samsung はプリント基板の量産を 2023 年から開始した。日系企業も例外ではなく、同じくプリント基板メーカーのメイコーはハノイ市で工場増強を公表している。シンガポールやマレーシアと比較した際の相違点としては、半導体の前工程を担う工場の設立が進んでいない点である。ASEAN 諸国の中で相対的に見ても人件費の安さは魅力である一方、電力などのインフラや電子部品産業の集積度は、上述した 2 カ国には及んでいない。ベトナムがより高付加価値な半導体産業の集積地として成長を遂げるためには、ASEAN 諸国の中での激しい競争に打ち勝つ必要があると言える。

これまでは ASEAN の中でも、半導体産業におい

て主導権を握りつつある国を例に挙げてきた。その他の国においても、フォロワーの立ち位置でありながら半導体産業の育成に注力している。例えば、インドネシアは 2024 年 11 月に、半導体サプライチェーンの後工程における高付加価値化を目指したロードマップを策定。先行するシンガポールやドイツと協同で半導体人材の育成機関を設立するなど、足掛かりを築き始めている。フィリピンは半導体産業に関する具体的な政策ロードマップは未発表である一方、米国が支援する半導体産業プログラム「Chips 法」の下、資金援助対象国の 1 つとして言及されている。タイは自動車産業を中心に工業化で先行した国であるが、半導体産業の誘致は他国より出遅れている。2025 年 2 月に半導体を含む先端電子部品の政策ロードマップを発表し、2029 年までに 2 兆円以上の投資案件承認を目指すなど、巻き返しを図っている状況である。

このように、ASEAN ではシンガポールやマレーシアを筆頭に、付加価値の高い前工程までを含む半導体産業の確立を狙っている。一方で、インドネシアやフィリピン、タイなどはフォロワーとして、まずはパッケージングや検査を中心とした後工程から誘致を狙う現状、と整理することができる。特にシンガポールやマレーシアは、古くから後工程を担う半導体メーカーが進出しており、続く形でプリント基板などの部品メーカーや、日系企業の強い素材メーカーが周辺に工場を設立している。多額な政府補助金や欧米先進国との技術・人材交流も相まって、ASEAN 諸国はグローバルサプライチェーンにおける重要な製造ハブ拠点としての存在感を増していくと考えられる。

一方で、25 年 4 月にトランプ大統領が公表した相互関税の影響を懸念する声がある。実際に、シンガポールには 10%、マレーシアには 24%、ベトナムには 46% など、驚異的な税率が上乘せされようとしており、そのまま施行された場合はサプライチェーン戦略の再考を迫られる可能性がある。ただし、各国の個別交渉による例外適用余地や、4 年後の政権交代による政策揺り戻し、そして産業移転に要する時間・コストを踏まえると、現時点で ASEAN の優位性が根本から崩れ去る可能性は低いと考えられる。